

	<b>Technisches Datenblatt</b>  <b>Jtec Ag15CuP</b>	Version / Datum	V1.0 / 04.05.2025
		Änderungsgrund	Neuerstellung
		Autor	TH
		Vorgängerversion	-

Jointec GmbH: Jtec Ag15CuP  
 ISO 17672: CuP 284  
 EN 1044: Cu 102  
 AWS A 5.8: CuP-9

## Chemische Zusammensetzung

	<i>Ag</i> [%]	<i>Cu</i> [%]	<i>P</i> [%]	<i>Andere</i> [%]	<i>Schmelzbereich</i> [°C]
Jtec Ag15CuP	15	Rest	5	-	645 – 800

## Charakteristik / Anwendung

Jtec Ag15CuP ist ein Silber-Kupfer-Phosphor-Lot mit hohem Silberanteil. Diese Legierung bietet sehr gute Fliesseigenschaften und Kapillarwirkung. Geeignet für Verbindungen von Kupfer mit Kupfer.

Empfohlen für Lötverbindungen, die starken thermischen Belastungen und Vibrationen ausgesetzt sind.

Betriebstemperatur der Lötverbindung: –70 °C bis +150 °C.

Nicht geeignet für schwefelhaltige Umgebungen sowie für Eisen- oder Nickellegierungen.

Erwärmungsmethoden:

Flammlöten, Induktionslöten, Widerstandslöten

Flussmittel:

AgCuP werden zum Löten von Kupfer verwendet, dazu wird kein Flussmittel benötigt.

Technische Lieferbedingungen gem. ISO 17672

## Verfügbarkeit

<i>Stäbe</i>	<i>Flussmittelummantelte Stäbe</i>	<i>Draht</i>	<i>Folie</i>	<i>Formteile</i>	<i>Pulver</i>	<i>Paste</i>
X	-	X	X	AA	-	-